



2017年3月期 決算説明会

2017年5月15日

TOWA株式会社

本日の主な説明内容

1. 2017年3月期 実績
2. 第1次中期経営計画の振り返り
3. 第2次中期経営計画の取組み
4. 2018年3月期 予想

本日の主な説明内容

- 1. 2017年3月期 実績**
2. 第1次中期経営計画の振り返り
3. 第2次中期経営計画の取組み
4. 2018年3月期 予想

2017年 3月期 連結業績結果（前年比）

（単位：億円）

	2016/3期 実績（※1）	当初計画	修正予想 （2/9修正公表）	2017/3期 実績	前年比
売上高	222.7	235.0	270.0	276.3	+ 24.1%
営業利益	19.5	21.0	35.0	38.3	+ 96.1%
経常利益	20.9	21.0	37.0	過去最高 41.3	+ 97.4%
当期純利益 （※2）	18.2	19.0	35.0	過去最高 38.6	+ 111.8%

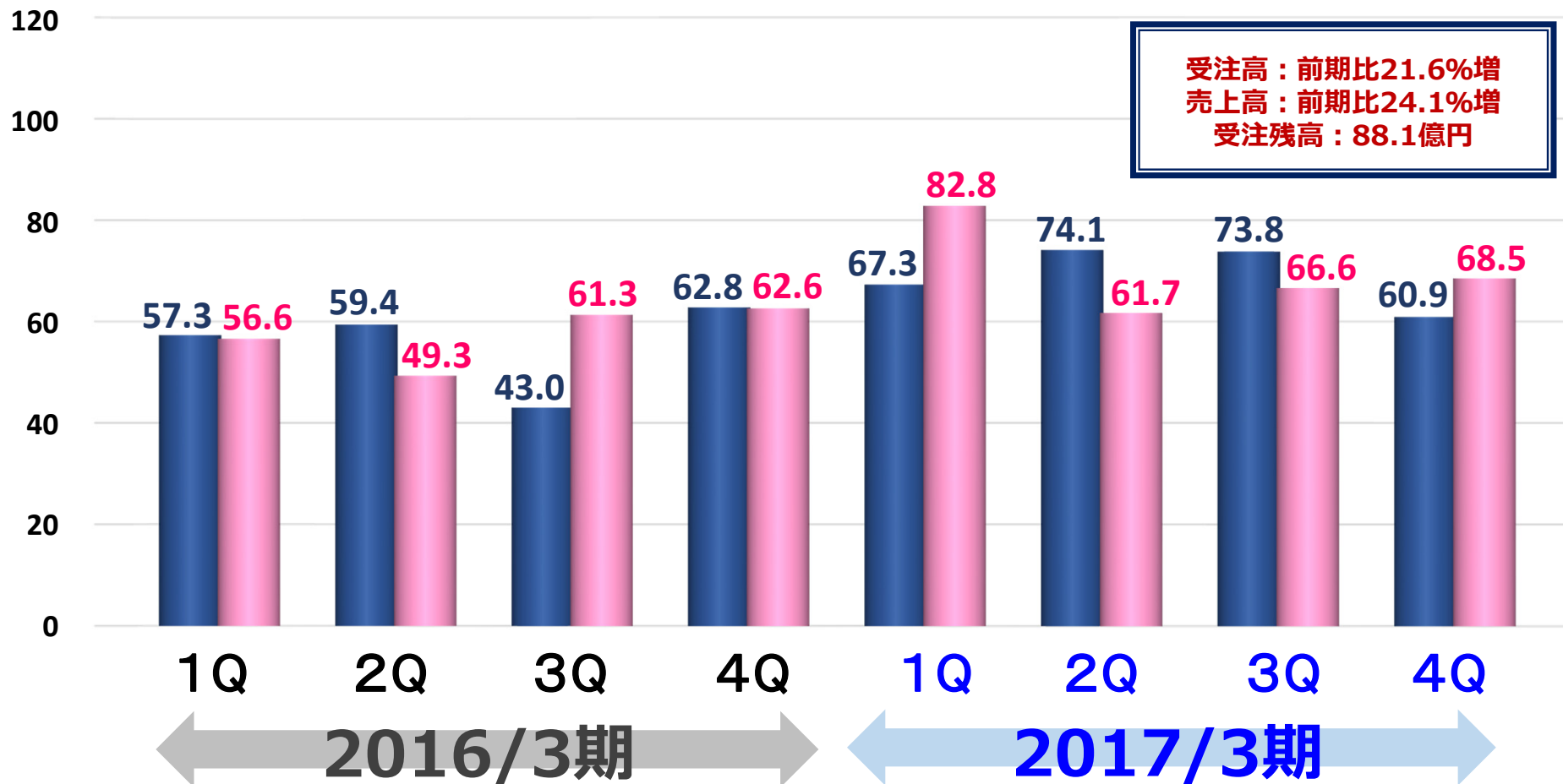
※1. 2017年3月期より会計方針の変更（収益認識基準の変更）を行っているため遡及適用後の数値を記載しております。

※2. 当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

受注・売上高の推移

(単位：億円)

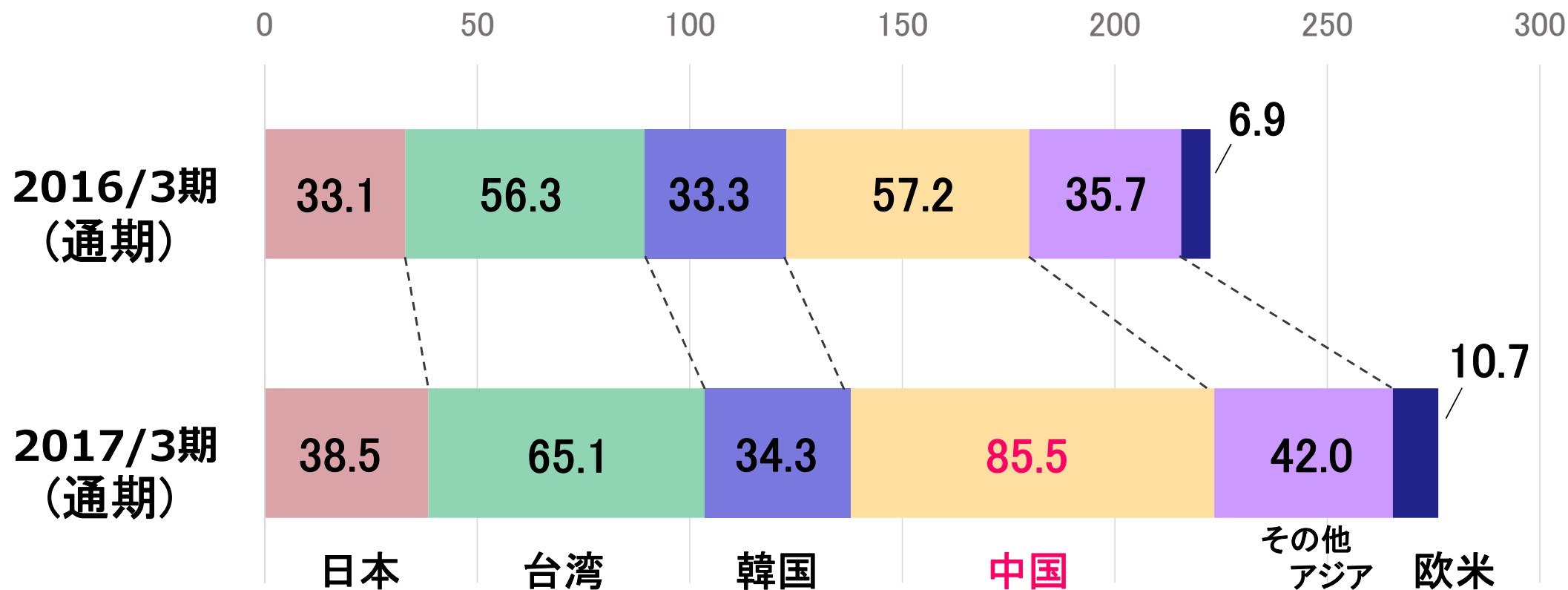
■ 売上高 ■ 受注高



2017年 3月期 地域別売上高（仕向地ベース）

中国向け売上が伸張

（単位：億円）



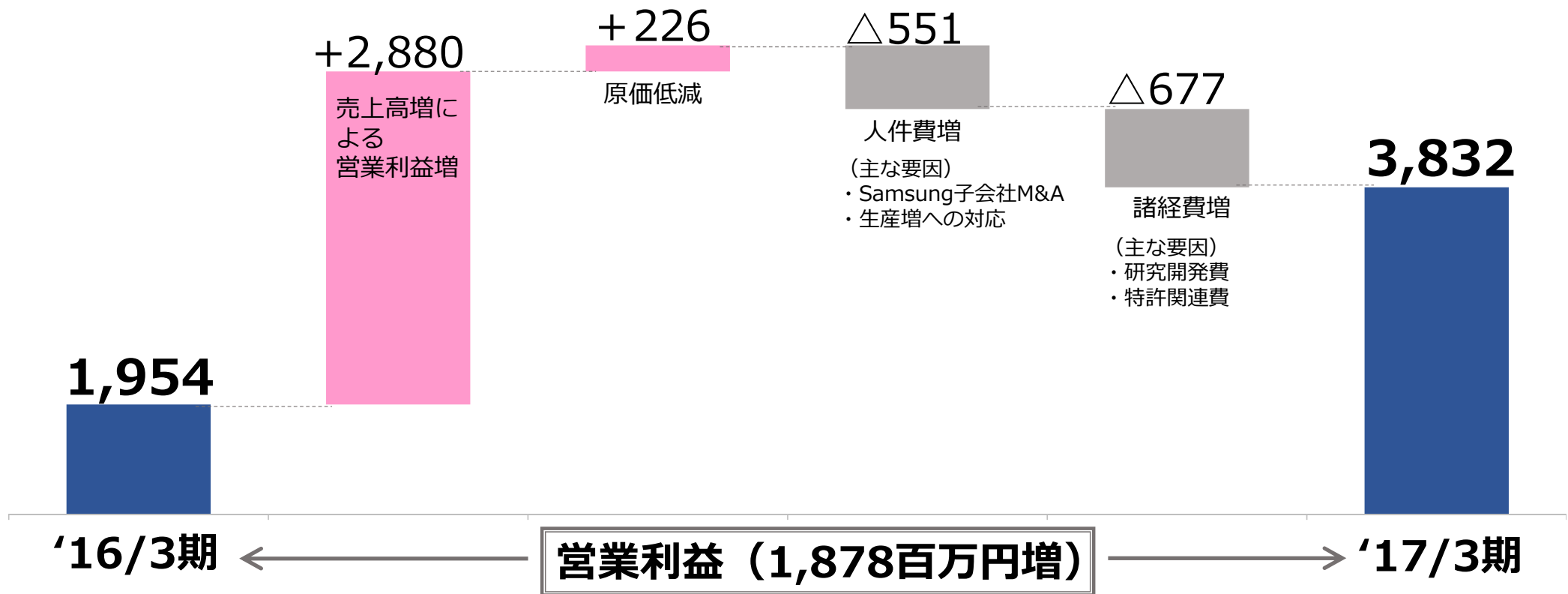
2017年 3月期 セグメント別売上高

(単位：億円)

	2016/3期 実績	2017/3期 実績	増減額	前年比
売上高	222.7	276.3	+ 53.6	+ 24.1%
半導体事業	177.4	226.0	+ 48.6	+ 27.4%
化成品事業	12.3	12.5	+ 0.2	+ 2.0%
新事業	33.0	37.8	+ 4.8	+ 14.6%

2017年 3月期 連結営業利益 増減要因分析

(単位：百万円)



本日の主な説明内容

1. 2017年3月期 実績
2. **第1次中期経営計画の振り返り**
3. 第2次中期経営計画の取組み
4. 2018年3月期 予想

第1次中期経営計画の振り返り

(単位：億円)

	2014年度		2015年度		2016年度		
	<2015/3期>		<2016/3期>		<2017/3期>		
	計画	実績 (※1)	計画	実績 (※1)	計画	実績	計画比
売上高	180	211	190	222	210	276	+ 31.6%
営業利益	10	19	15	19	21	38	+ 82.5%
当期純利益 (※2)	8	19	13	18	14	38	+ 176.3%

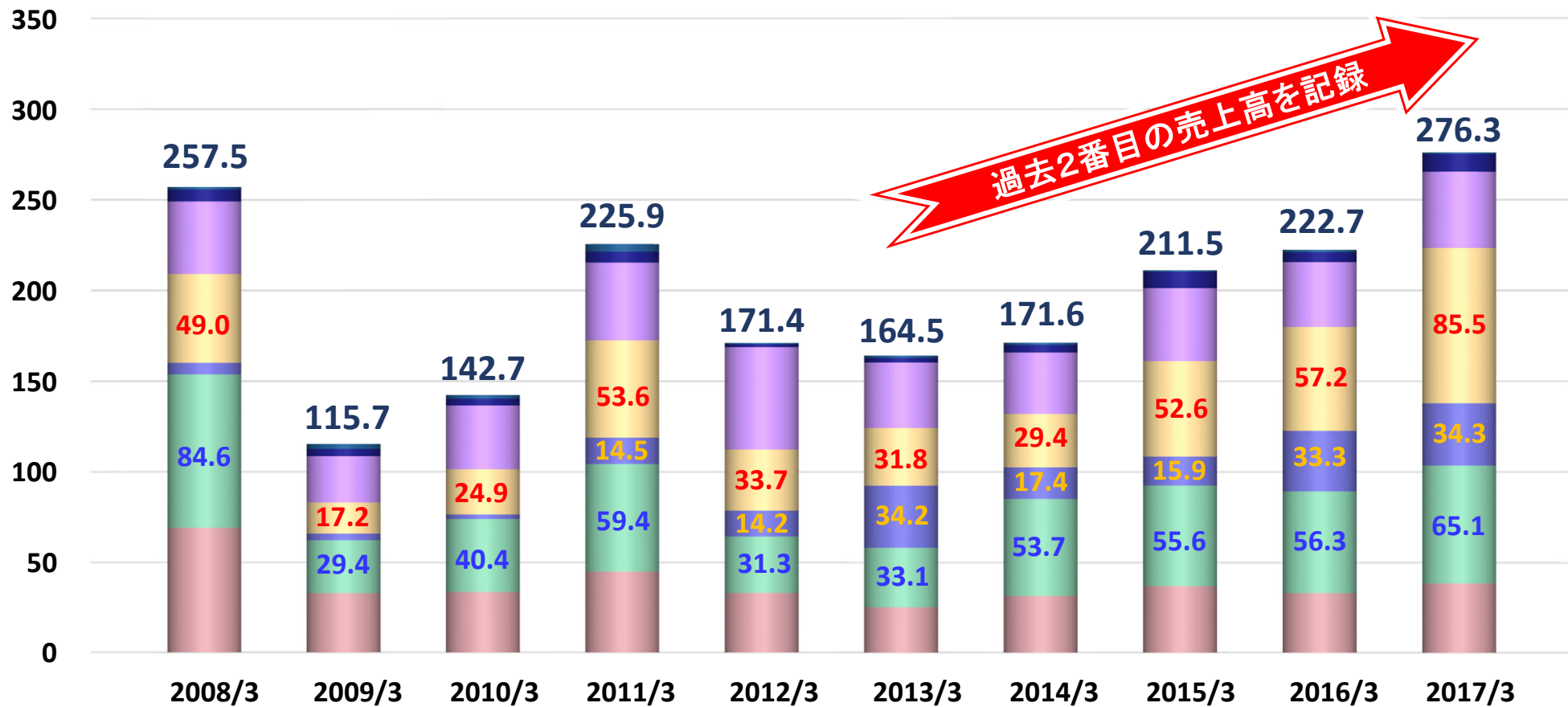
※1. 会計方針の変更を行っているため遡及適用後の数値を記載しております。

※2. 当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

第1次中期経営計画の振り返り - 売上 -

■ 日本 ■ 台湾 ■ 韓国 ■ 中国 ■ その他アジア ■ 米州 ■ 欧州

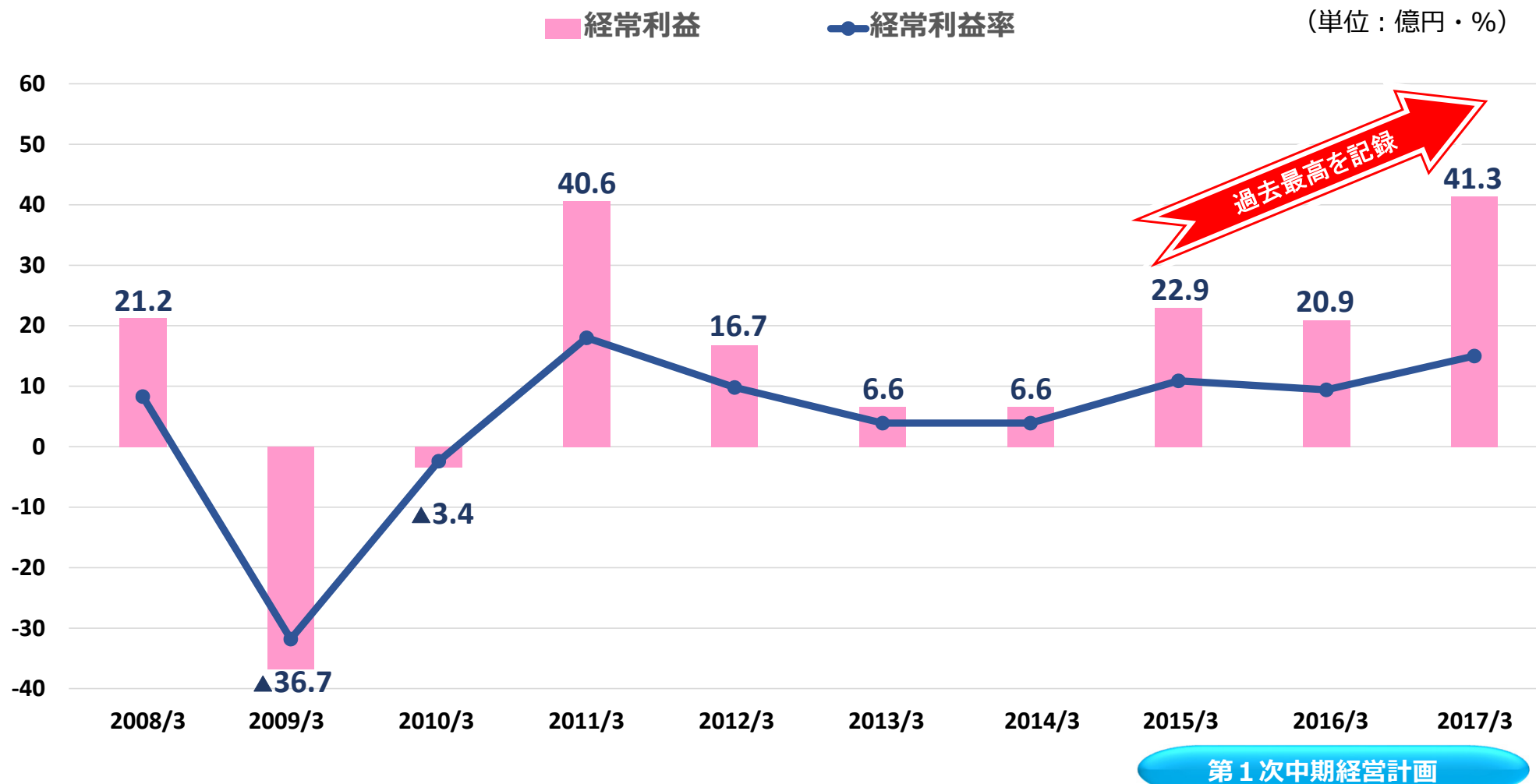
(単位：億円)



過去2番目の売上高を記録

第1次中期経営計画

第1次中期経営計画の振り返り – 利益 –

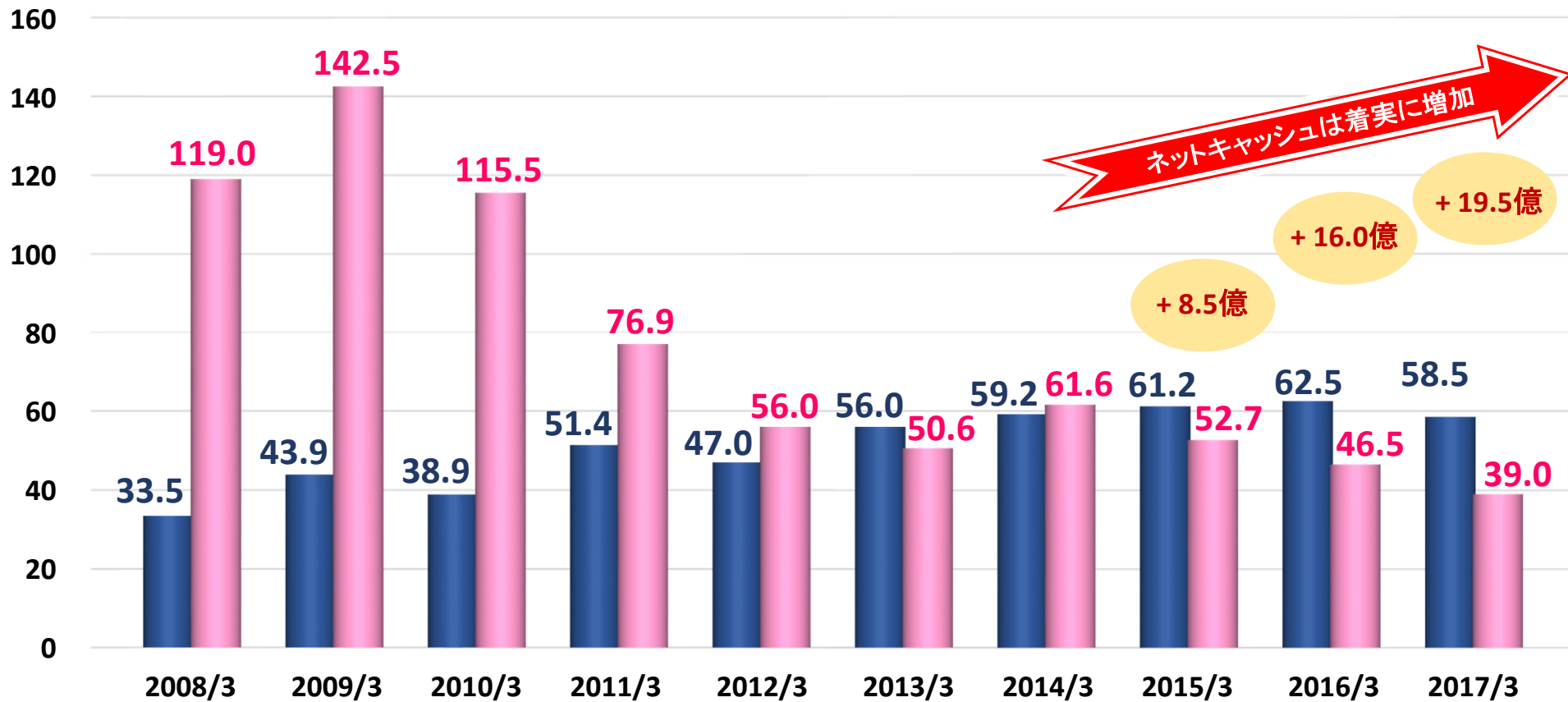


第1次中期経営計画の振り返り – CF –

■ 現預金残高

■ 借入金残高

(単位：億円)



第1次中期経営計画

第1次中期経営計画の振り返り

2014年～2016年

第1次中期(3カ年)経営計画

テーマ 「市場を創造する」ものづくりの実践

≫ 成長戦略 ‹‹

- コンプレッション技術による
モールディング事業の伸張・他分野への展開
- シンギュレーション事業の市場シェアアップ
- 「新たな市場」創造と事業化へのチャレンジ

第1次中期経営計画の振り返り

- コンプレッション技術による
モールドング事業の伸張・他分野への展開



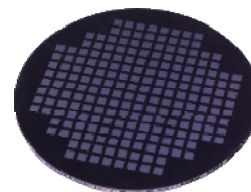
第22回

半導体・オブ・ザ・イヤー2016

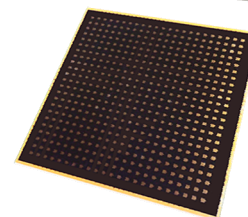
半導体製造装置部門 グランプリ 受賞

FOWLP対応モールド装置

CPM1080



φ 450



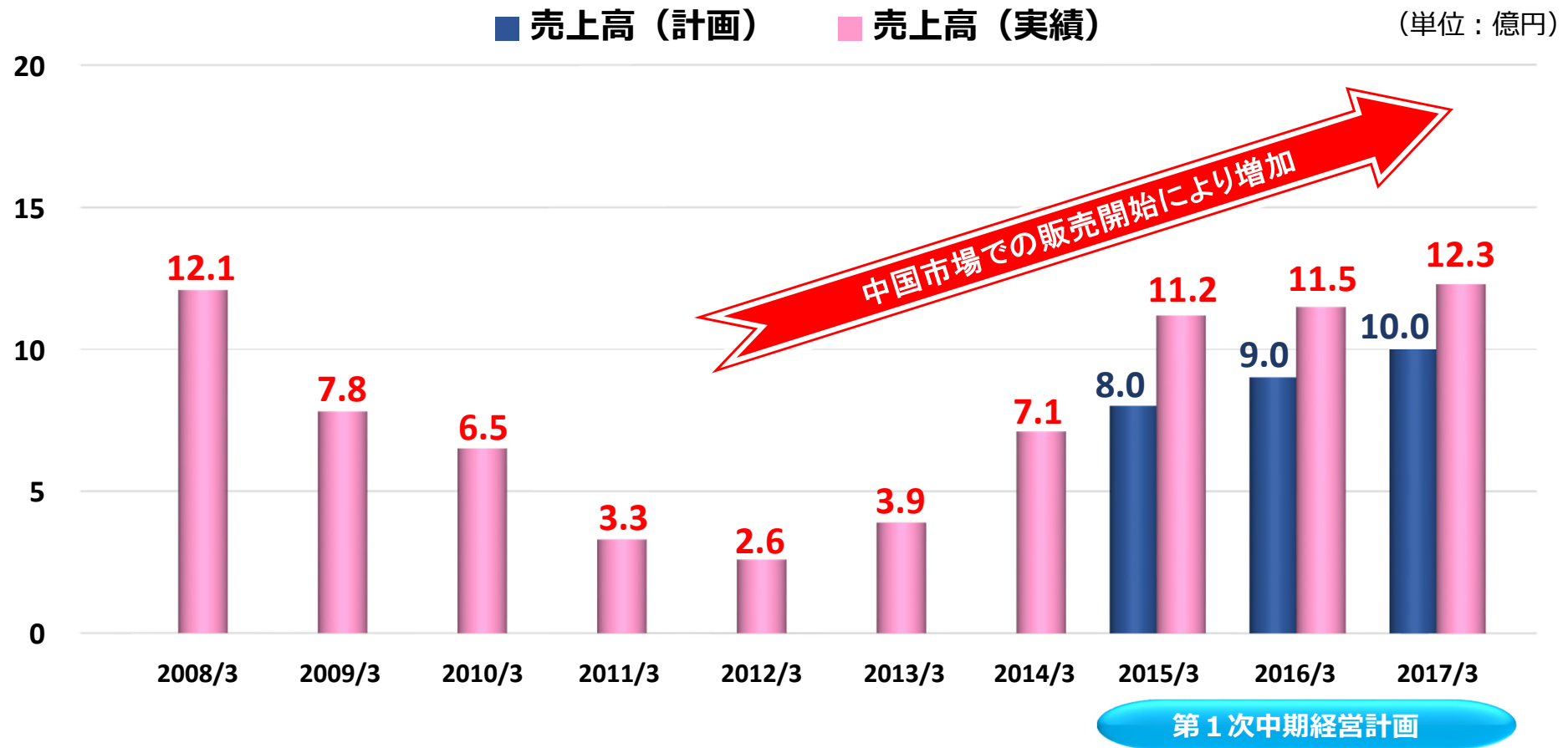
660×620 mm

超大判パネル対応モールド装置

CPM1180

第1次中期経営計画の振り返り

● シンギュレーション事業の市場シェアアップ



第1次中期経営計画の振り返り

● 「新たな市場」 創造と事業化へのチャレンジ

新事業 コーティング (バンセラ)

基本性能

表面を高硬度化
優れた防汚性

新たな取組み

打錠用臼杵等への展開
民生分野への展開



応用展開 新事業 ナノテク (超微細加工)

基本性能

超微細形状加工技術
超精密微細金型複製技術

新たな取組み

医薬品 微細印刷原版
光学部品



新事業 ツーリング (CBN工具)

基本性能

高精度・長寿命・低価格
再研削・特注品対応

新たな取組み

販売代理店網拡大
台湾MIRDCと業務提携



新事業 ガラス加工

基本性能

穴あけ・切断等
フィルムを用いたダメージのない加工

新たな取組み

半導体関連

- ・サブストレート基板の代替品
- ・0.1mm薄板ガラスへの微細加工



半導体事業 応用展開 新事業 TSS事業

基本性能

提案力・データベース

新たな取組み

TEN-SYSTEM
ラボ機能+トレーニングセンター
改造ビジネス 中古機販売



第1次中期経営計画の振り返り

- » 基盤強化 «
- 営業活動網・活動形態の再構築
 - 高効率生産体制の追求
 - グローバルリーダーの育成

工場増築



株式会社バンディック

工場増築



TOWA株式会社 九州事業所

Samsung子会社のモールド事業M&A



TOWA韓国株式会社

工場増築



TOWA半導体設備（蘇州）有限公司

ラボ機能設置

- TOWA半導体設備（蘇州）有限公司
- TOWA USA Corporation
- TOWA Europe B.V.
- TOWA韓国株式会社 <今夏設置予定>

グローバルリーダー育成



本日の主な説明内容

1. 2017年3月期 実績
2. 第1次中期経営計画の振り返り
- 3. 第2次中期経営計画の取組み**
4. 2018年3月期 予想

第2次中期経営計画の取組み

TOWA10年ビジョン

2014年～2024年

長期テーマ **「ものづくり企業の真価に挑む」**

第2次中期経営計画

2017年～2019年

テーマ **「エンパワーメントで挑戦と飛躍を」**

“TOWAのエンパワーメント”とは

従業員の自主的・自律的な行動を促し、

組織としてのパフォーマンスを最大化すること。

第2次中期経営計画の取組み

第1次中期経営計画

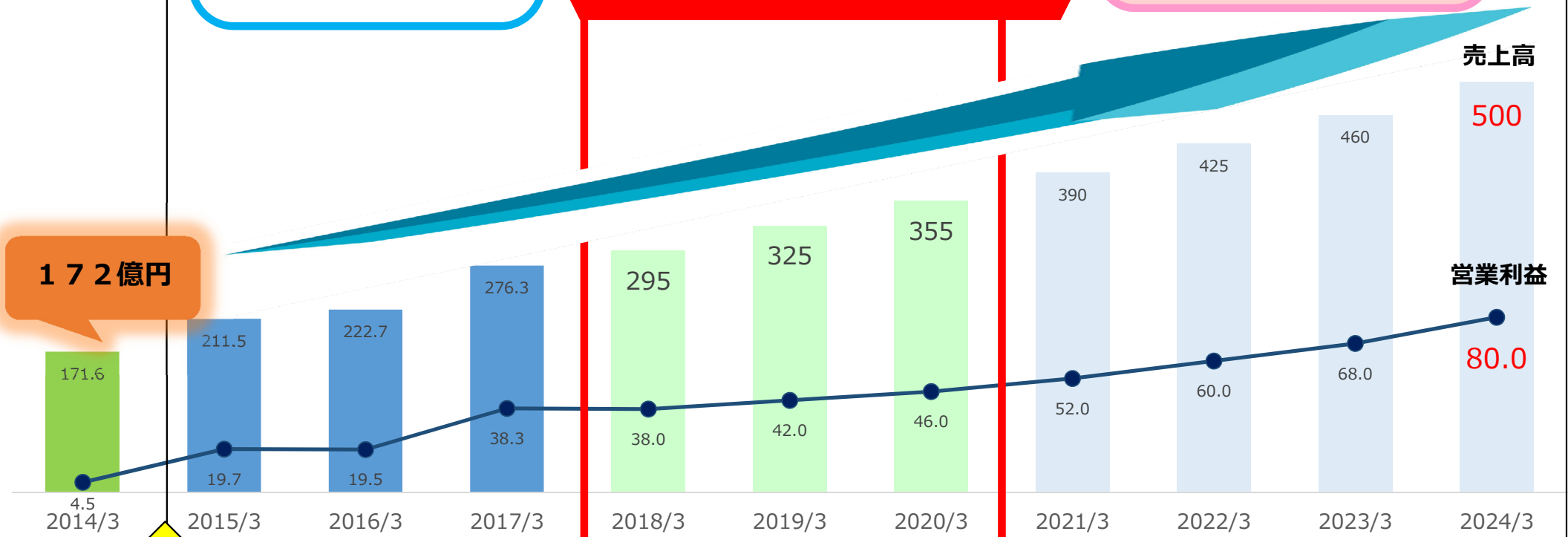
第1次中計目標達成
 連結売上高：276億円
 営業利益：38億円

第2次中期経営計画

連結売上高：355億円
 営業利益：46億円

第3次中期経営計画

連結売上高：500億円
 営業利益：80億円



172億円

「10年ビジョン」を発表

第2次中期経営計画の取組み

(単位：億円)

	2018/3期	2019/3期	2020/3期
売上高	295 (295)	325	355
営業利益	38 (40)	42	46
経常利益	38 (41.5)	42	46
当期純利益	26 (28.5)	29	32

※ 1. 当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

※ 2. 括弧書きは平成29年5月11日公表の連結業績予想値であります。

第2次中期経営計画の取組み

(単位：億円)

	2018/3期	2019/3期	2020/3期
売上高	295	325	355
半導体事業	242	260	277
化成品事業	13	15	16
新事業	40	50	62

第2次中期経営計画の取組み

事業方針

1. 最先端パッケージ市場での更なる優位性の確保と既存パッケージ市場の掘り起こし
2. 成形品事業の新市場開拓による業績拡大
3. トータル・ソリューション・サービス(TSS)事業と新事業への経営資源投入による収益機会の拡大
4. コーポレート・ガバナンスの強化による更なる企業価値の向上

第2次中期経営計画の取組み

1. 最先端パッケージ市場での更なる優位性の確保と 既存パッケージ市場の掘り起こし

- **PMC納期 1カ月対応開始**
- **次世代コンプレッション装置の開発**
- **トランスファ装置の短納期対応**
- **シンギュレーション装置の差別化**
- **IMEC※との共同研究開発**

※ベルギーのルーヴェン市に本社を置く国際研究機関
(Interuniversity Micro Electronics Center)



「PMC1040-D」

TOWA
コンプレッション方式モールド装置
4月から納期を1カ月に短縮

TOWAは4月から、樹脂封止モールド装置の受注が好調な独自開発のコンプレッション方式の期を1カ月に短縮する。

中国、台湾、韓国などのOSAT（後工程の外注委託）指紋認証デバイス用や3Dフラッシュメモリー、DRAMなどハイエンドデバイス用の受注増に迅速に対応。これまで受注から出荷まで3カ月かかっていた同装置の納期を、コンカレントエンジニアリング手法と法を導入し、3分の1に縮めることができた。

対象装置は売れ筋の「PMC1040-D」。同時に現在、月産5台の同装置の生産能力を順次拡大していく計画だ。

今回の納期短縮に導入したコンカレントエンジニアリング手法では、製品の製造プロセスを構成する複数の工程を同時並行で進め、各部門での情報共有や共同作業、部品の標準化を行った。

コンプレッション方式モールド装置は、顆粒樹脂を採用した圧縮成形法（コンプレッション）による一括樹脂封止の装置。樹脂流動がなく樹脂使用量を削減できるほか、基板の大型化やワイヤ細線化が可能など、従来のトランスファモールド装置の課題を解決。樹脂パッケージを薄くできることも評価を得ている。

16年度上期は32台を販売した。通期の半導体製造装置事業の売上げ約240億円のうち、30億〜40億円が同装置になる見通しだ。

▲電波新聞[3月1日付掲載]

第2次中期経営計画の取組み

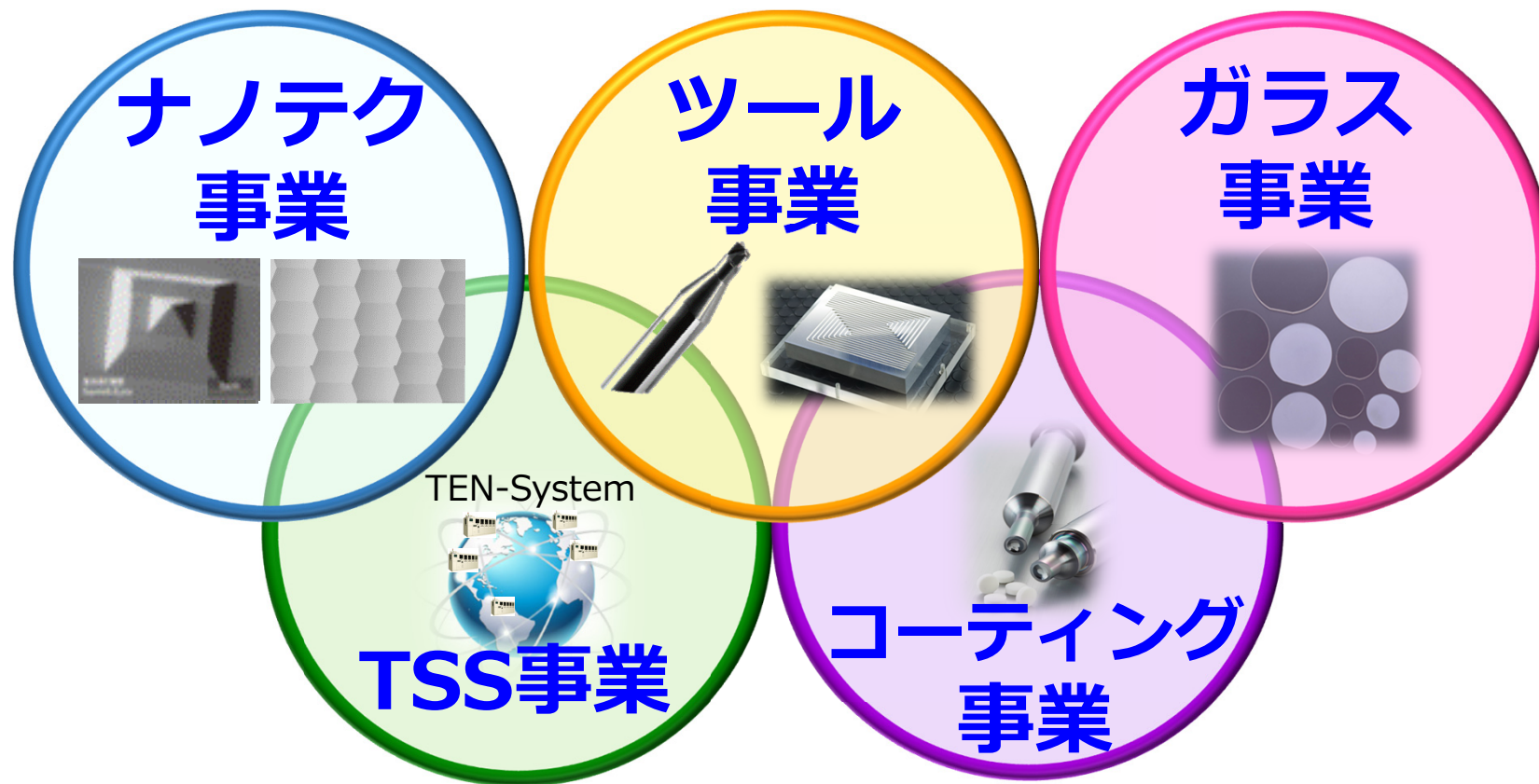
2. 成形品事業の新市場開拓による業績拡大

- 既存受託ビジネスの伸張
- 新たな領域で受託ビジネスの開拓
- 新事業による自社製品の立上げ



第2次中期経営計画の取組み

3. トータル・ソリューション・サービス(TSS)事業と 新事業への経営資源投入による収益機会の拡大



第2次中期経営計画の取組み

半導体事業

応用展開

新事業

TSS事業



「世界のモールドプロセスをTOWAに!!!」

➤ LE(ライフエクステンション)プログラム

装置・ユニットの改善・改良・改造など、当社装置および生産ラインを未永く使っていただくためのプログラム

➤ 中古機販売

➤ 予防保全（年間契約）

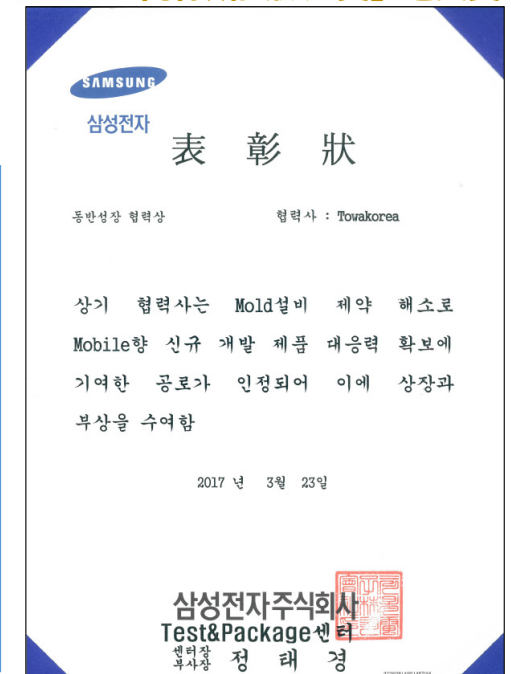
- ・ TEN-System
- ・ リモートメンテナンス

➤ 部品供給

➤ トレーニングセンター



三星電子株式会社より
「同伴成長協力賞」を受賞



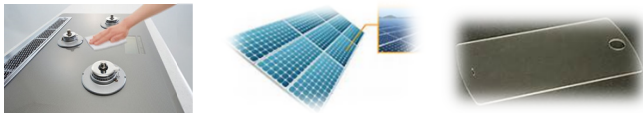
第2次中期経営計画の取組み

新事業

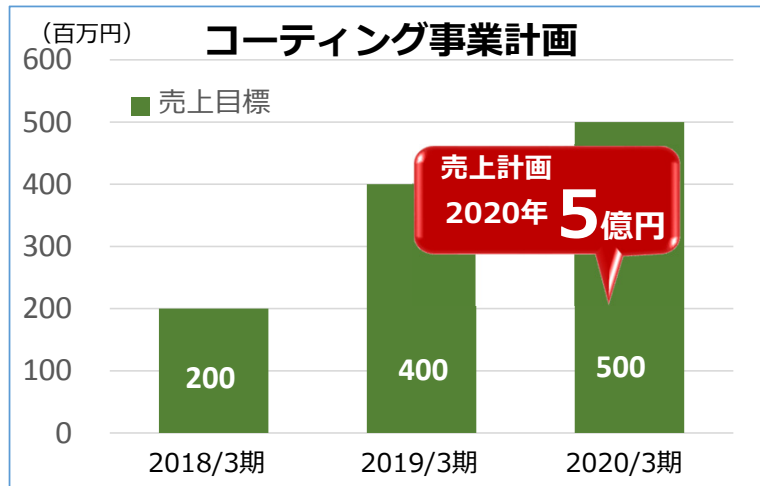
コーティング（バンセラ）



打錠分野への普及率向上



ガラス製品への普及率向上



応用展開

新事業

ナノテク（超微細加工）



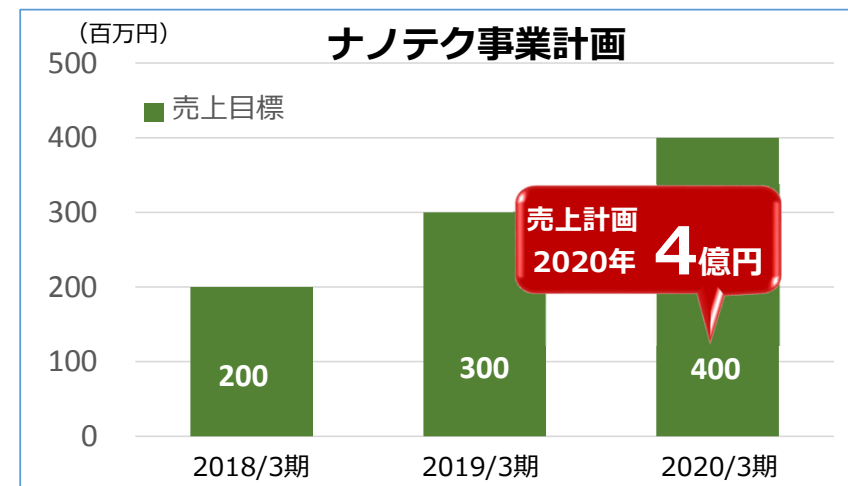
細胞培養分野における商品開発



空中映像素子レンズの開発



ナノプリントプレート量産化



第2次中期経営計画の取組み

新事業

ツーリング (CBN工具)

TOWA海外販売会社

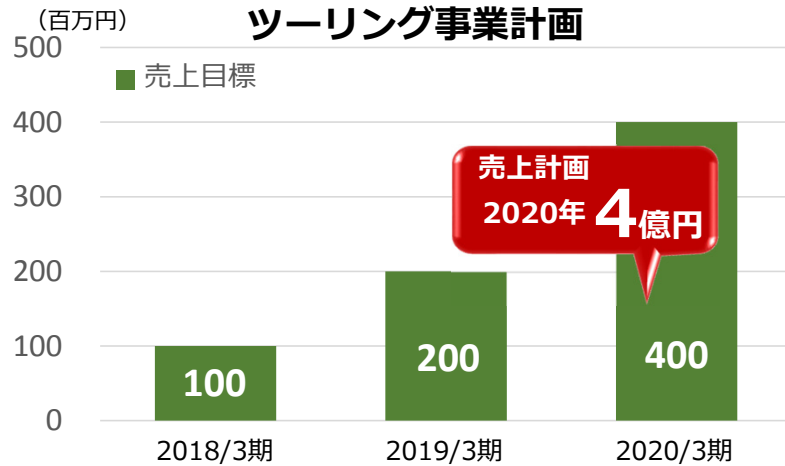
財団法人 (MIRDC)
金属工業研究開発センター

国内外販売代理店網の拡大



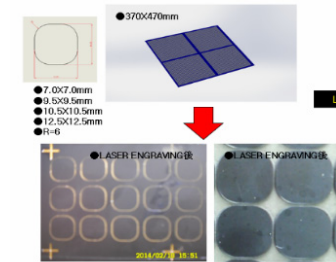
グローバル販売体制の構築

超硬製品の開発



新事業

ガラス加工



アプリケーションと加工方法のバリエーション増加



第2次中期経営計画の取組み

4. コーポレート・ガバナンスの強化による 更なる企業価値の向上

ガバナンスの検討

- 自社成長のストーリーと整合した仕組み作り
- 当面の対応と積み残しの明確化

CG報告書・内部統制
システムの開示

投資家との対話

- 機関投資家向けIR
- 個人投資家向けIR

ガバナンスの改善

- 積み残し課題への対応
- 投資家との対話による論点のフィードバック

投資家からの信頼



TOWAファンの獲得

本日の主な説明内容

1. 2017年3月期 実績
2. 第1次中期経営計画の振り返り
3. 第2次中期経営計画の取組み
4. **2018年3月期 予想**

2018年 3月期 連結業績予想

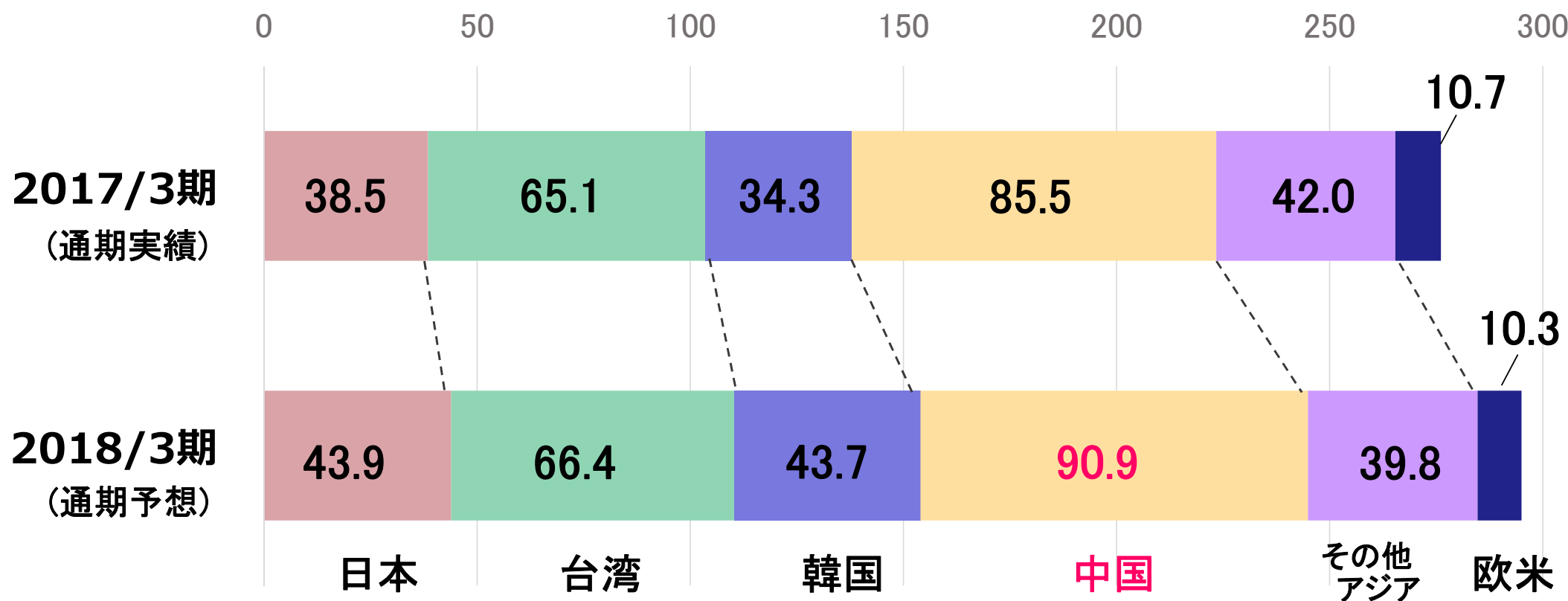
(単位：億円)

	2017/3期 実績	2018/3期 予想	増減額	前年比
売上高	276.3	295.0	+ 18.7	+ 6.8%
営業利益	38.3	40.0	+ 1.7	+ 4.4%
経常利益	41.3	41.5	+ 0.2	+ 0.4%
当期純利益	38.6	28.5	▲ 10.1	▲ 26.3%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2018年地域別売上予想（仕向地ベース）

（単位：億円）



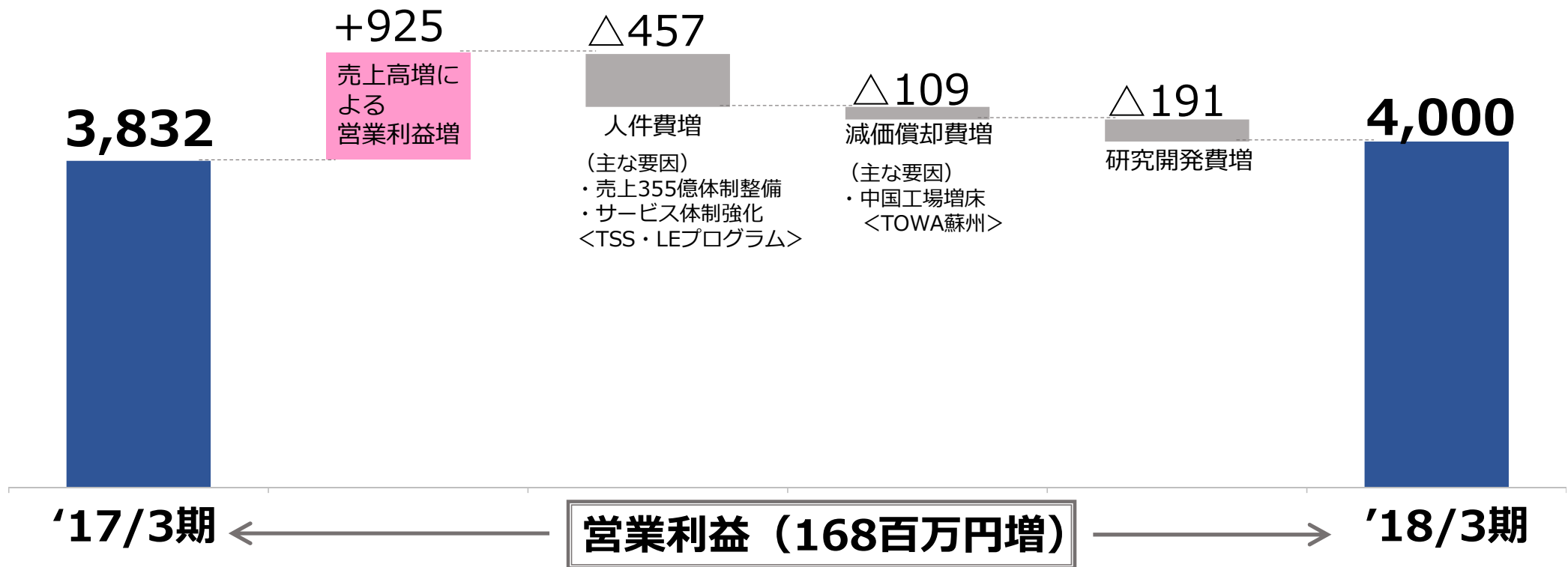
2018年 3月期 セグメント別予想

(単位：億円)

	2017/3期 実績	2018/3期 予想	増減額	前年比
売上高	276.3	295.0	+ 18.7	+ 6.8%
半導体事業	226.0	242.0	+ 16.0	+ 7.1%
化成品事業	12.5	13.0	+ 0.5	+ 4.0%
新事業	37.8	40.0	+ 2.2	+ 5.7%

2018年 3月期 営業利益予想 増減要因分析

(単位：百万円)



設備投資・配当予想

	2017/3期 実績	2018/3期 予想
設備投資	12.4 億円	25.0 億円
配 当	16.0 円	16.0 円